

2024日本东京半导体展览会展

产品名称	2024日本东京半导体展览会展
公司名称	展会销售部经理-胡甜甜
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市莲花南路1951号格兰大厦403室
联系电话	17891916299 17891916299

产品详情

SEMICON JAPAN

展会时间：2024年12月11-13日

展会地点：日本东京有明国际展览中心

主办单位：日本国际半导体设备及材料协会（SEMI）

展会周期：一年一届

组展单位：上海贸升展览服务有限公司—日本展专业服务商

不参展人员，我司可提供组团观展服务，提供签证，机票，酒店，接送机，入场证办理等服务

另我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，5年多次）材料简单，出签快

展会简介：

日本东京国际半导体电子元器件展览会Semicon

Japan是日本规模最大、最具影响力的类展览会之一。日本东京国际半导体电子元器件展览会Semicon Japan是一个国际化的半导体专项展览会，由Semi举办，该展每年一届在东京举办。

日本向全球半导体制造业供应了三分之一的半导体设备和超过一半的材料。SEMICON Japan位于半导体供应链的核心位置，来自日本和其他地区的750多家参展公司云集于此，为您的技术挑战和业务成功展示创新的解决方案。

市场情况：

上世纪80年代，通过实施超大规模集成电路计划（VLSI），日本半导体产业获得了飞跃式发展，成为世界半导体产业强国之一。进入90年代后，日本半导体产业受到内部的体制弊端和外部的激烈竞争的挑战，发展速度明显趋缓，在全球半导体产业中的地位不断下滑。近年来，随着日本经济开始出现好转，半导体行业设备投资迅速增长，产业呈现复苏迹象。在2003年-2006年间，日本累计完成新设备投资310亿美元，占同期全球半导体设备投资总额的近1/4，截止到2007年10月，日本国内已建成12英寸生产线17条，12英寸芯片产能从2006年的27.2万片/月，到年底预计将扩充到42.9万片/月，同比增长约58%。

积极为半导体产业制定发展规划，是日本政府支持本国半导体产业发展最主要的体现。从早期的超大规模集成电路计划（VLSI）、“超尖端电子技术开发计划”到新一代半导体的研究计划“飞鸟计划”（ASUKA）、“未来计划”（MIRAL）（目前正在执行第二期）以及“SOC基础技术开发计划”（ASPLA），均反映了通过政府部门牵头、企业和研究机构参与，进行半导体关键基础技术研发，生产验证、推动工艺标准化的努力。

参展范围：

- 1、半导体设备和材料、集成电路、半导体分立器件、半导体照明、半导体设备；
- 2、半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备、半导体激光设备等；
- 3、导体分立器件产品与应用技术等；
- 4、半导体光电器件；
- 5、光伏太阳能、多晶硅提纯及辅助设备、晶体硅电池及辅助设备、TFT—LCD设备；
- 6、电子元器件和组件、电子生产设备\ SMT设备（SMT生产线shebao、辅助及检测设备、OKI系列产品、防静电设备）、微组装设备（粘片、键合、清洗、检测、封焊设备）、工业辅料、粘结于密封、涂敷材料、表面处理、润滑产品、焊接辅助材料等。

展会补贴

凡参加我司团组并符合中小企业条件的参展企业，均有机会获得国家中小企业国际市场开拓资金补贴。补贴额度不同省份不同，具体额度来电咨询。

我司组展优势：

- 1、多年来专注日本展会，可为客户解决突发及疑难问题。
- 2、良好的摊位位置和价格优势。
- 3、境外行程和酒店食宿等安排一向优惠合理便捷，得到广大参展商和商务考察企业单位的一致好评！
- 4、常年操作日本展经验和熟悉当地国家情况的专业带团人员。
- 5、从摊位确认到展台搭建及展览品运输和商务签证培训与补贴办理，公司一条龙的专业服务理念，打造展览服务行业第一品牌！
- 6、在日本设有公司办事处和仓库，可提供展会服务以外的其它相关服务。（如：租车，样品寄存，个人定制旅游等）

电子元器件和组件、电子生产设备\ SMT设备（SMT生产线shebao、辅助及检测设备、OKI系列产品、防静电设备）、微组装设备（粘片、键合、清洗、检测、封焊设备）、工业辅料、粘结于密封、涂敷材料、表面处理、润滑产品、焊接辅助材料等。

展会补贴